

2016-2022年中国LED封装市场研究与前景趋势报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2016-2022年中国LED封装市场研究与前景趋势报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/E17161Y99S.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话： 400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真： 010-60343813

Email： sales@abaogao.com

联系人： 刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

2014年LED下游应用市场需求旺盛，特别是LED照明井喷式发展，带动了LED封装市场迅猛发展，但是由于产品价格下降过快，导致企业普遍增产不增收，但整体规模还是有27%的较高增长。

2014年开始，国内LED封装厂商大量使用国产化芯片，国内LED应用企业也乐于接受高性价比的国内器件，也大大降低封装企业的成本。在供销两旺的形势下，封装企业为避免出现芯片短缺情况，纷纷与芯片企业签订供需协议以保证充足、稳定的货源，同时获得较高性价比的芯片。其中鸿利、聚飞、国星分别同三安光电签署战略合作协议，计划在1年内共计向三安光电采购7.3亿元的LED芯片，此外木林森与澳洋顺昌签订2年采购4亿元芯片合同，长方半导体与苏州新纳晶签订5265万元芯片采购合同。

2014年大部分已上市的LED封装大厂获得佳绩，上榜LED封装企业呈两极分化现象：木林森今年地位往前大跨了一步，并且在2015年初成功上市，俨然成为内地封装厂的龙头企业，国星光电、鸿利光电、聚飞光电等上市企业的业绩稳步上升，瑞丰光电、万润科技等上市企业却业绩不太理想，净利下降。

而在产品方面，随着照明应用市场份额越来越大，中国本土厂商的市场占有率逐步提升。照明用LED器件、显示屏需求量增幅较快，但背光LED、景观照明因趋于饱和呈下降趋势。LED照明市场竞争加大导致封装企业产品毛利率有所下降。开发新工艺提高利润成为中国内地封装大厂发展方向。缩小LED器件体积成为市场主流，小面积、高光效也逐渐成为LED开发与应用的趋势。倒装芯片2015年开始在中国内地流行，目前在海外和台湾地区都已比较成熟，但是在内地市场进展比较迟缓，由于倒装芯片封装良品率低、工艺成本比较高，以中小封装企业为主的内地封装主流市场暂时还难以接受，目前只有少数几家企业涉足。而COB封装在中国内地市场的产业规模 and 市场份额越来越大，逐渐成为市场主流之一。

在良好的产业政策引导下，以及持续的技术创新，LED封装行业伴随LED产业快速增长。据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据，2012年，国内LED封装产值达到320亿元，较2011年增长12.3%；2013年LED封装产值较上年增长25.9%，达到403亿元；2014年我国LED封装规模约517亿元，较2013年增长了28%。

《2016-2022年中国LED封装市场研究与前景趋势报告》由智研数据研究中心公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、知识产权局、智研数据中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。

报告揭示了LED封装行业市场潜在需求与市场机会，报告对中国LED封装做了重点企业经营状况分析，并分析了中国LED封装行业发展前景预测。为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据。

报告目录：

第一章 LED封装相关概述 17

1.1 LED封装简介 17

1.1.1 LED封装作用 17

1.1.2 LED封装的形式 19

1.1.3 LED封装的结构类型 20

1.1.4 LED封装的工艺流程 20

1.1.5 LED封装对封装材料要求 24

1.2 LED封装的常见要素 24

1.2.1 LED引脚成形方法 24

1.2.2 LED弯脚及切脚 25

1.2.3 LED清洗 25

1.2.4 LED过流保护 28

1.2.5 LED焊接条件 29

第二章 2013-2015年中国LED封装产业整体运营态势分析 30

2.1 2013-2015年世界LED封装业的发展总况 30

2.1.1 世界LED封装业发展规模及应用 30

2.1.2 世界LED封装企业分析 30

2.1.3 世界LED封装技术先进性分析 31

2.2 2013-2015年中国LED封装业的发展综述 31

2.2.1 中国LED封装业发展成果 31

2.2.2 产值增长情况 32

2.2.3 产量增长情况 32

2.2.4 价格分析 33

2.2.5 利好因素 33

2.3 2013-2015年国内重要LED封装项目的建设进展 33

2.3.1 韩企投资扬州兴建LED封装基地 33

- 2.3.2 西安经开区LED封装线项目投产 34
- 2.3.3 长治高科LED封装项目竣工投产 34
- 2.3.4 敬亭园中园LED支架及封装项目开建 35
- 2.3.5 源力光电LED封装线正式投产 35
- 2.4 SMD LED封装 36
 - 2.4.1 SMD LED封装市场发展简况 36
 - 2.4.2 SMD LED封装技术壁垒较高 38
 - 2.4.3 SMD LED封装产能尚未过剩 39
 - 2.4.4 SMD LED封装受益于芯片价格下降 42
- 2.5 2013-2015年中国LED封装业发展中存在的热点问题探讨 43
 - 2.5.1 制约我国LED封装业发展的因素 43
 - 2.5.2 国内LED封装企业面临的挑战 45
 - 2.5.3 封装业销售额与海外企业差距明显 47
 - 2.5.4 传统封装工艺成为系统成本瓶颈 48
- 2.6 促进中国LED封装业发展的策略 48
 - 2.6.1 做大做强LED封装产业的对策 48
 - 2.6.2 发展LED封装行业的措施建议 50
 - 2.6.3 LED封装业发展需加大研发投入 51
 - 2.6.4 我国LED封装业应向高端转型 51

第三章 2013-2015年中国LED封装市场新格局透析 53

- 3.1 2013-2015年中国LED封装市场发展态势 53
 - 3.1.1 中国成中低端LED封装重要基地 53
 - 3.1.2 国内LED封装企业发展不平衡 54
 - 3.1.3 中国LED封装市场缺乏大型企业 55
 - 3.1.4 LED产业上游厂商涉足封装市场 57
 - 3.1.5 台湾LED封装产能向大陆转移 57
- 3.2 中国LED封装企业分布状况 58
 - 3.2.1 2013年LED封装企业区域分布 58
 - 3.2.2 2014年LED封装企业区域分布 59
- 3.3 广东省LED封装业 63
 - 3.3.1 主要特点 63

3.3.2 重点市场 64

3.3.3 发展趋势 65

第四章 2013-2015年中国LED封装行业技术研发进展状况 67

4.1 中外LED封装技术的差异 67

4.1.1 封装生产及测试设备差异 67

4.1.2 LED芯片差异 67

4.1.3 封装辅助材料差异 68

4.1.4 封装设计差异 68

4.1.5 封装工艺差异 69

4.1.6 LED器件性能差异 70

4.2 中国LED封装技术发展概况 71

4.2.1 封装技术影响LED产品可靠性 71

4.2.2 中国LED业专利集中在封装领域 72

4.2.3 中国LED封装业的技术特点 73

4.2.4 LED封装技术水平不断提升 73

4.2.5 LED封装业技术研发仍需加强 73

4.3 LED封装关键技术介绍 74

4.3.1 大功率LED封装的关键技术 74

4.3.2 显示屏用LED封装的技术要求 79

4.3.3 固态照明对LED封装的技术要求 84

第五章 2013-2015年中国LED封装设备及封装材料的发展 86

5.1 LED封装设备市场分析 86

5.1.1 我国LED封装设备市场概况 86

5.1.2 LED封装设备国产化亟需加速 87

5.1.3 发展我国LED封装设备业的思路 88

5.2 LED封装材料市场分析 89

5.2.1 LED封装主要原材介绍 89

5.2.2 我国LED封装材料市场简析 89

5.2.3 部分关键封装原材料仍依赖进口 90

5.2.4 LED封装用基板材料市场走向分析 90

5.3 LED封装支架市场 91

5.3.1 国内LED封装支架市场格局分析 91

5.3.2 LED封装支架技术未来发展趋势 91

5.3.3 我国LED封装支架市场前景广阔 92

第六章 2013-2015年中国LED封装产业竞争新形态分析 94

6.1 2013-2015年中国LED封装市场竞争格局 94

6.1.1 中国采购影响世界封装市场格局 94

6.1.2 我国LED封装市场各方力量简述 94

6.1.3 国内LED封装市场竞争加剧 95

6.1.4 本土LED封装企业整合步伐加速 96

6.2 2013-2015年中国LED封装企业竞争力简析 96

6.2.1 2015年本土封装企业竞争力排名 96

6.2.2 2015年本土LED封装企业竞争力排名 101

6.3 2016-2022年中国LED封装竞争趋势预测分析 105

第七章 2013-2015年全球LED封装顶尖企业分析 108

7.1 科锐 (CREE) 108

7.1.1 企业概况 108

7.1.2 企业LED封装运营态势 108

7.1.3 企业发展战略分析 108

7.2 日亚化学 (NICHIA) 109

7.2.1 企业概况 109

7.2.2 企业LED封装运营态势 109

7.2.3 企业发展战略分析 113

7.3 飞利浦 (Philips) 113

7.3.1 企业概况 113

7.3.2 企业LED封装运营态势 113

7.3.3 企业发展战略分析 116

7.4 三星LED (Samsung LED) 117

7.4.1 企业概况 117

7.4.2 企业LED封装运营态势 117

7.4.3 企业发展战略分析 118

7.5 首尔半导体 (SSC) 119

7.5.1 企业概况 119

7.5.2 企业LED封装运营态势 119

7.5.3 企业发展战略分析 120

第八章 2013-2015年中国台湾主要LED封装重点企业运营分析 122

8.1 亿光电子 122

8.1.1 企业概况 122

8.1.2 企业LED封装运营态势 122

8.1.3 企业发展战略分析 124

8.2 光宝集团 124

8.2.1 企业概况 124

8.2.2 企业LED封装运营态势 125

8.2.3 企业发展战略分析 126

8.3 东贝光电 127

8.3.1 企业概况 127

8.3.2 企业LED封装运营态势 128

8.3.3 企业发展战略分析 129

8.4 宏齐科技 129

8.4.1 企业概况 129

8.4.2 企业LED封装运营态势 130

8.4.3 企业发展战略分析 130

8.5 台积电 130

8.5.1 企业概况 130

8.5.2 企业LED封装运营态势 131

8.5.3 企业发展战略分析 131

8.6 艾笛森 134

8.6.1 企业概况 134

8.6.2 企业LED封装运营态势 134

8.6.3 企业发展战略分析 135

第九章 2013-2015年中国内地主要LED封装重点企业 136

9.1 国星光电(002449) 136

9.1.1 企业概况 136

9.1.2 企业主要经济指标分析 136

9.1.3 企业盈利能力分析 138

9.1.4 企业偿债能力分析 139

9.1.5 企业运营能力分析 141

9.1.6 企业成长能力分析 144

9.2 雷曼光电 144

9.1.1 企业概况 144

(一) 企业偿债能力分析 145

(二) 企业运营能力分析 146

(三) 企业盈利能力分析 149

9.1.2 企业LED封装运营态势 151

9.1.3 企业发展战略分析 152

9.3 鸿利光电 152

9.1.1 企业概况 152

(一) 企业偿债能力分析 152

(二) 企业运营能力分析 154

(三) 企业盈利能力分析 157

9.1.2 企业LED封装运营态势 159

9.1.3 企业发展战略分析 159

9.4 大族光电(002008) 159

9.4.1 企业概况 159

9.4.2 企业主要经济指标分析 160

9.4.3 企业盈利能力分析 160

9.4.4 企业偿债能力分析 161

9.4.5 企业运营能力分析 163

9.4.6 企业成长能力分析 166

9.5 深圳市瑞丰光电子有限公司 167

9.5.1 企业概况 167

9.5.2 企业主要经济指标分析 167

- 9.5.3 企业盈利能力分析 167
- 9.5.4 企业偿债能力分析 169
- 9.5.5 企业运营能力分析 171
- 9.5.6 企业成长能力分析 174
- 9.6 宁波升谱光电半导体有限公司 174
 - 9.6.1 企业概况 174
 - 9.6.2 企业主要经济指标分析 175
 - 9.6.3 企业盈利能力分析 175
 - 9.6.4 企业偿债能力分析 176
 - 9.6.5 企业运营能力分析 178
 - 9.6.6 企业成长能力分析 181
- 9.7 南京汉德森科技股份有限公司 182
 - 9.7.1 企业概况 182
 - 9.7.2 企业主要经济指标分析 182
 - 9.7.3 企业盈利能力分析 183
 - 9.7.4 企业偿债能力分析 184
 - 9.7.5 企业运营能力分析 186
 - 9.7.6 企业成长能力分析 189

第十章 2016-2022年中国LED封装产业发展趋势及前景 190

- 10.1 2016-2022年LED封装产业未来发展趋势 190
 - 10.1.1 功率型白光LED封装技术发展趋势 190
 - 10.1.2 LED封装技术将向模块化方向发展 192
 - 10.1.3 LED封装产业未来发展走向分析 193
- 10.2 2016-2022年中国LED封装市场前景展望 194
 - 10.2.1 我国LED封装市场发展前景乐观 194
 - 10.2.2 LED封装产品应用市场将持续扩张 194
 - 10.2.3 中国LED通用照明封装市场规模预测 195

第十一章 2016-2022年中国LED封装产业投资前景预测 196

- 11.1 2016-2022年中国LED封装行业投资概况 196
 - 11.1.1 LED封装行业投资特性 196

- 11.1.2 LED封装具有良好的投资价值 200
- 11.1.3 LED封装投资环境利好 200 (zyyzg)
- 11.2 2016-2022年中国LED封装投资机会分析 201
 - 11.2.1 LED封装投资热点 (LED照明、LED照明电视) 201
 - 11.2.2 国家节能减排衍生LED封装投资机会 202
- 11.3 2016-2022年中国LED封装投资风险及防范 203
 - 11.3.1 技术风险分析 203
 - 11.3.2 金融风险分析 205
 - 11.3.3 政策风险分析 206
 - 11.3.4 竞争风险分析 207
- 11.4 专家建议 208

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/E17161Y99S.html>